

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金公司 胡炯益、张怡康 中信证券 蒋文凯 迪策投资 杨光、彭骏 金元顺安基金 徐勇
时间	2021年6月3日下午14:15-16:15
地点	北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：张阿斌 副总经理、证券事务代表：刘波 证券事务专员：孙玉华
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分： 上市公司介绍了赛微电子的发展历程以及最新动态，近年来，面向万物互联与人工智能时代，赛微电子已形成以半导体为核心的业务格局，MEMS、GaN成为分处不同发展阶段、聚焦发展的战略性业务。与此同时，公司围绕相关产业开展投资布局，服务主业。基于业界顶级专家工程师团队、所掌握的成熟工艺以及持续扩张的MEMS领域先进的8英寸产能，赛微电子积极把握市场需求，为全球客户提供高标准的MEMS芯片工艺开发及晶圆制造服务；同时基于业界顶级技术团队及优异的产品性能，积极快速地布局GaN产业链，面向新型电源、智能家电、通讯设备、数据中心等领域提供GaN（氮化镓）外延材料、GaN器件及配套应用方案。赛微电子执行长期发展战略，致力于成为一家立足本土、国际化发展的知名半导体科技

企业集团。

第二部分：上市公司解答提问，主要提问及解答如下：

1、请问贵公司特种电子业务剥离进展如何？

答：公司从去年开始陆续剥离原有航空电子、导航等非半导体业务，2020年初至今公司近一年来已经/正在对外转让或关闭的子公司超过15家；2021年3月，公司决议剥离上市公司体系内涉及惯性和组合导航业务的最后一家特种电子业务全资子公司，该交易事项已于2021年5月经主管部门批复同意，目前正在交易执行阶段。该交易完成后，公司MEMS与GaN业务在主营业务中的占比预计将超过97%。

2、请介绍贵公司北京MEMS代工产线的产能情况，产线资产的折旧摊销压力如何？

答：公司北京MEMS产线的建设总产能为3万片/月，目前一期产能1万片/月已建成，2020年Q4内部调试，今年Q1开始晶圆验证，预计在本季度可以实现正式生产，今年下半年预计实现50%的产能，即月产5000片晶圆，2022年实现一期100%的产能，即月产10,000片晶圆；2023年实现月产1.5万片晶圆，2024年实现月产2万片晶圆，2025年实现月产2.5万片晶圆，2026年实现月产3万片晶圆。随着北京产线工艺制造水平的逐渐成熟，若订单及客户需求的增长超出预期，则上述自2022年起的产能爬坡进度有可能加快。

在产线折旧摊销方面，对于公司北京MEMS产线（FAB3）的固定资产折旧政策，公司严格按照财政税务部门的相关政策和行业惯例执行，机器设备方面公司目前选择按10年进行折旧，厂房按照20年进行折旧，北京MEMS产线的相关资产已从2020年10月转固并按会计准则规定计提折旧。根据FAB3截至2020年末的资产情况（不考虑新添设备），静态预计每年归

母折旧金额约在 6000 万元-7000 万元区间。随着后续产能的扩张建设，该金额将相应增长。

3、请问贵公司瑞典 MEMS 产线与北京 MEMS 产线未来将如何分工定位？

答：依据公司 MEMS 业务发展的整体规划，瑞典与北京 MEMS 产线是分工协作的互补关系，虽然瑞典产线已具备 8 吋线的量产能力，在纯 MEMS 代工企业中产能规模也处于领先地位，但与 IDM 厂商及传统 CMOS 代工厂相比，瑞典产线的产能规模处于整个 MEMS 代工市场的中等水平，当地扩产后的产线也无法消化大规模量产订单；北京 MEMS 产线运转稳定后，则可以承接规模较大的通信、工业、消费电子领域订单，且同时提供工艺开发及大规模量产代工服务。

北京 MEMS 产线成熟后，公司将继续保持瑞典产线的运营，一方面可以实时跟踪国际 MEMS 技术及行业发展、保持技术领先地位；另一方面可以协助解决小批量、高工艺难度的订单。瑞典与北京产线的相互合作，将有利于增强公司 MEMS 业务面向全球客户的整体服务能力、丰富客户及产品组合。

4、请问公司 MEMS 工艺开发和晶圆制造阶段的定价依据是如何制定的？工艺开发和晶圆制造的结构占比如何？将来会如何变化？

答：因为 MEMS 是一个高度差异化、定制化的产业，因此不管是工艺开发还是晶圆制造，其定价都是非常不同的，并非根据晶圆消耗量或者开发时间制定统一的收费标准，但结算的节点都是晶圆的交付。代工厂商的核心收费逻辑与依据是其所掌握的技术积累及知识产权，同时也取决于相关产品代工服务的市场竞争程度。当前的市场环境下，可靠的工艺开发及晶圆制造能力是代工厂商最核心的话语权。在公司 2020 年的 MEMS 业务

中，工艺开发和晶圆制造的产值构成约四六开，因行业特点及瑞典产能有限，服务的工艺开发客户数量多于晶圆量产制造客户，从交付的晶圆数量和单价看，工艺开发业务的平均单价更高，晶圆制造的交付数量更多。将来随着北京 MEMS 产线的投产，预计晶圆制造贡献的产值绝对额及占比将显著提高。

5、请问贵公司瑞典产线升级完成后产能提升了多少？未来是否会继续扩产？良率情况如何？

答：自并购完成后公司便积极支持瑞典产线升级及持续扩产。瑞典产线在 2017-2020 年进行了超过 3 亿元人民币的资本投入，2020 年 9 月，瑞典原有 6 英寸产线（FAB1）升级切换成 8 英寸产线，原有 8 英寸产线（FAB2）亦已完成扩产，合计 MEMS 晶圆产能提升至 7,000 片/月的水平，产能在 2019 年末的基础上继续提升了 30%，且目前因重点客户需求仍在持续进行资本投入。但从公司长期发展战略以及对产线定位方面的考虑，瑞典产线未来继续扩充的空间有限，未来业务发展的增量将主要取决于北京产线的投产、爬坡及扩充情况。

由于不同产品的高度差异化、定制化以及工艺复杂、代工难度较高，规模效应的发挥存在一定难度，MEMS 代工的良率一般低于传统 IC 制造的良率，就目前情况来看，瑞典产线 80+%的产能利用率以及 70+%的良率已属于业内领先水平，由于瑞典产线近年来进行了大规模的升级扩产，在此状态下的产线潜力尚未完全发挥，随着新增产能的投入及生产逐步稳定，瑞典产线的产能利用率及良率在未来仍有继续提升的空间。

6、请问贵公司预计何时可以取得瑞典 ISP 的许可结果？

答：公司瑞典子公司 Silix 自 2020 年 11 月向瑞典 ISP 提交许可申请后持续跟踪动态，此前预计可以在今年 5 月底前取得最终结果，但该时间属于公司当地顾问所提供的参考预计时间，

并非瑞典 ISP（战略产品检验局）承诺的办理完结时间，公司希望能够尽快取得是否授予许可的最终结果，但目前仍需要继续等待瑞典 ISP 的通知，由于是一国政府部门行为，需以其最终正式通知为准。公司北京 FAB3 与瑞典 FAB1&2 的技术与人员交流已进行数年，FAB3 自身也早已组建国际化工艺及制造工程师团队、投入大量工艺技术研发、并积极与战略客户开展技术合作，FAB3 的生产运营不以瑞典 ISP 的许可为前提条件。

7、请问贵公司 MEMS 业务目前的客户主要包括哪些？

答：公司 MEMS 业务客户主要包括通讯、生物医疗、工业汽车和消费电子四大领域。根据过去几年的业务数据，各领域的需求均在增长，但不同业务领域在不同时期可能会产生一些明显的波动因素，比如去年以来在全球范围内爆发的 COVID-19 疫情，就显著刺激了下游生物医疗客户的 MEMS 工艺开发及晶圆制造需求。由于公司过去几年的产能有限，因此公司的收入与订单结构并不能完全、准确地反映市场需求。但总体来说各领域的需求均在增长，静态看生物医疗、通讯领域的需求增长表现得更为明显，动态看我们看好各领域的未来需求。

8、请问贵公司芯片晶圆价格的变化趋势如何？

答：公司 MEMS 工艺开发与晶圆代工的产能一直比较紧张，订单排期较长，从芯片晶圆单价的计算结果来看，近几年单片晶圆价格的上涨是持续且快速的，2017-2020 年公司 MEMS 晶圆的平均售价分别约为 1700 美元/片、1800 美元/片、2200 美元/片及 2700 美元/片。

9、请问贵公司北京 8 英寸 MEMS 国际代工线项目的设备主要从哪里采购，国内厂商的采购比例有多少？设备采购是否会受到中美贸易战的影响？

答：北京 MEMS 产线的设备主要从荷兰、美国、日本等知名半导体设备厂商采购，因为 MEMS 是集成电路的一个专业分支，国内专门供应商较少，同时作为公司在本土建设的第一条商业规模量产线，为确保产线能够尽快投入运营并加快产能及良率爬坡，公司的基本思路是在工艺参数、设备配置等方面完全复刻子公司瑞典 Silex 的 8 英寸产线，因此厂务系统设备的国内外采购均有，比较均衡，有一部分是属于合资厂商或外资厂商的境内公司；但一期工艺制造设备从数量和金额角度均是以海外采购为主，今后公司将根据实际情况逐步提高国内设备的采购比例。MEMS 的 8 英寸设备主要为定制化设备，同时全球 8 英寸设备的供应及存量较有保障，一般也存在备选供应商，回顾厂务系统设备及一期工艺制造设备的采购，虽然付出了许多心血，整体还是比较顺利的，从最终结果看未受到中美贸易关系太大的影响。

10、我们看到，国内也有其他厂商纷纷建设 MEMS 产线，请问这些产线与公司是否会形成竞争？公司 MEMS 业务的竞争优势主要体现在哪些方面？

答：从产业发展规律和趋势看，竞争不可避免，但是公司在 MEMS 芯片工艺开发及晶圆制造方面已经深耕二十年，存在着显著的竞争优势，主要如下：（1）突出的全球市场竞争地位；（2）先进的制造及工艺技术，掌握了多项在业内极具竞争力的工艺技术和工艺模块；（3）标准化、结构化的工艺模块；（4）覆盖广泛、积累丰富的开发及代工经验；（5）产业长期沉淀、优秀且稳定的人才团队；（6）丰富的知识产权；（7）中立的纯晶圆厂模式；（8）前瞻布局、陆续实现的规模产能与供应能力。

随着 MEMS 产业整体的广泛及规模化发展，各产业链环节的专业分工趋势越来越明显，除非规模巨大，否则单品类产品并无必要且往往难以支撑需要长期重资产、智力密集投入并维

	<p>护的制造产线,而各类无晶圆 Fabless 或轻晶圆 Fablite 设计公司不断兴起,各类 MEMS 需求不断涌现,将给专业晶圆制造和封装测试厂商带来巨大的发展机遇。当然,一个在万物互联与人工智能时代背景下具备确定性发展前景的巨大市场必将孕育一大批不同商业模式的 MEMS 厂商,具体发展情况仍需持续观察。</p> <p>11、请问贵公司昨天发布的 FAB3 完成竣工验收公告应如何解读? 是否意味着 FAB3 即将开始量产?</p> <p>答: 公司北京 FAB3 的设计总产能为 3 万片 MEMS 晶圆/月; 一期产能为 1 万片 MEMS 晶圆/月, 一期产能已于 2020 年 9 月建成并达到投产条件, 自 2020 年第四季度至今持续进行产线的内部调试以及与合作客户进行工艺及产品验证。昨日公司收到北京经济技术开发区行政审批局下发的文件, 公司 FAB3 符合竣工验收的各项条件, 最终完成竣工验收。FAB3 的竣工验收是启动量产的必要不充分条件。</p> <p>12、请问贵公司向特定对象发行股票事项的最新情况?</p> <p>答: 公司于今年 3 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京赛微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]680 号), 对公司本次定增感兴趣的投资机构及投资者较多, 公司持续与一批看好在万物互联与后摩尔时代中 MEMS、GaN 产业未来发展的各类资本与投资者就公司本次非公开发行事项保持沟通, 相关工作仍在进行中, 公司后续会根据相关规定及工作进展履行相应程序及信披义务。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 6 月 3 日